

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二四年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2025年2月13日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二四年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二四年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 5.392 億美元，同比增長 18.4%，環比增長 2.4%。
- 毛利率 11.4%，同比上升 7.4 個百分點，環比下降 0.8 個百分點。
- 母公司擁有人應占損失 2,520 萬美元，上年同期及上季度分別為母公司擁有人應占溢利 3,540 萬美元及 4,480 萬美元，主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期及上季度均為外幣匯兌收益。

二零二五年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約在 5.3 億美元至 5.5 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 9%至 11%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事白鵬先生對二零二四年第四季度及全年業績評論道：

“很榮幸首次代表華虹半導體參與業績發佈。公司二零二四年第四季度銷售收入為 5.39 億美元，單季度毛利率為 11.4%，均符合指引。二零二四年全年實現銷售收入 20.04 億美元，全年毛利率為 10.2%。”

“對華虹半導體而言，2024 年是挑戰與機遇並存的一年。市場需求複雜多變，消費領域復蘇、部分新興應用市場快速成長，帶動公司圖像傳感器、電源管理等平臺表現良好，但中高端功率器件的需求仍待改善。面對激烈的市場競爭，公司仍保持了營收與產能的穩定，整體業績呈現逐季提升趨勢。全年平均產能利用率接近 100%，在全球晶圓代工企業中處於領先水平。”

白總繼續補充道：“2024 年也是繼往開來的一年。公司位於無錫的第二條 12 英寸產線順利建成投產，標誌著公司在戰略發展路上又邁上了一個新臺階。2025 年，華虹半導體將圍繞新工藝平臺和各工藝平臺的迭代加強研發投入，擴大新產線的產能，圍繞關鍵新興產業不斷變化的需求，繼續與國內外重點客戶建立戰略合作，進一步夯實公司在特色工藝晶圓代工領域的領先地位。同時，公司也將進一步提升營運效率和加強成本控制，為股東創造出更大的價值。”

電話會議公告

日期 2025年2月13日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

04:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/hgm38253> 作線上直播

(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN
(個人身份識別碼)。

<https://register.vevent.com/register/BIb57631fcc7794af1af448487dae1e61e>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先進 “特色 IC + Power Discrete” 的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有 “8 英寸 + 12 英寸” 先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	539,177	455,361	526,306	18.4 %	2.4 %
毛利	61,426	18,220	64,007	237.1 %	(4.0)%
毛利率	11.4 %	4.0 %	12.2 %	7.4	(0.8)
經營開支	(110,626)	(95,063)	(81,430)	16.4 %	35.9 %
其他(損失)/收入淨額	(40,468)	87,600	51,797	(146.2)%	(178.1)%
稅前(損失)/溢利	(89,668)	10,757	34,374	(933.6)%	(360.9)%
所得稅開支	(6,596)	(7,210)	(11,461)	(8.5)%	(42.4)%
期內(損失)/溢利	(96,264)	3,547	22,913	(2,814.0)%	(520.1)%
淨利潤率	(17.9)%	0.8 %	4.4 %	(18.7)	(22.3)
以下各方應佔：					
母公司擁有人	(25,199)	35,386	44,816	(171.2)%	(156.2)%
非控股權益	(71,065)	(31,839)	(21,903)	123.2 %	224.5 %
持有人應佔每股盈利					
基本	(0.015)	0.021	0.026	(171.4)%	(157.7)%
攤薄	(0.015)	0.021	0.026	(171.4)%	(157.7)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,213	951	1,200	27.5 %	1.1 %
產能利用率 ¹	103.2 %	84.1 %	105.3 %	19.1	(2.1)
淨資產收益率 ²	(1.6)%	2.4 %	2.8 %	(4.0)	(4.4)

二零二四年第四季度

- 銷售收入 5.392 億美元，同比增長 18.4%，主要得益於付運晶圓數量上升，部分被平均銷售價格下降所抵消；環比增長 2.4%，主要得益於平均銷售價格及付運晶圓數量上升。
- 毛利率 11.4%，同比上升 7.4 個百分點，主要得益於產能利用率同比大幅提升；環比下降 0.8 個百分點。
- 經營開支 1.106 億美元，同比和環比分別上升 16.4% 和 35.9%，主要由於研發工程片開支上升，及新工廠的運營費用上升。
- 其他損失淨額 4,050 萬美元，上年同期及上季度分別為其他收入淨額 8,760 萬美元及 5,180 萬美元，主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期及上季度為外幣匯兌收益，以及本季度政府補貼減少。
- 所得稅開支 660 萬美元，同比下降 8.5%，環比下降 42.4%。
- 期內損失 9,630 萬美元，上年同期及上季度分別為期內溢利 350 萬美元及 2,290 萬美元。
- 母公司擁有人應佔損失 2,520 萬美元，上年同期及上季度分別為母公司擁有人應佔利潤 3,540 萬美元及 4,480 萬美元。
- 基本每股盈利-0.015 美元，上年同期為 0.021 美元，上季度為 0.026 美元。
- 淨資產收益率(年化) -1.6%，同比下降 4.0 個百分點，環比下降 4.4 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

經營業績概要
(以仟美元計, 每股盈利和營運數據除外)

	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (已審核)	同比
銷售收入	2,003,993	2,286,113	(12.3)%
毛利	205,128	487,096	(57.9)%
毛利率	10.2%	21.3%	(11.1)
經營開支	(360,904)	(333,057)	8.4 %
其他收入淨額	21,984	19,540	12.5 %
稅前(損失)/溢利	(133,792)	173,579	(177.1)%
所得稅開支	(6,593)	(47,154)	(86.0)%
年內(損失)/溢利	(140,385)	126,425	(211.0)%
淨利潤率	(7.0)%	5.5 %	(12.5)
以下各方應佔:			
母公司擁有人	58,108	280,034	(79.2)%
非控股權益	(198,493)	(153,609)	29.2 %
持有人應佔每股盈利			
基本	0.034	0.189	(82.0)%
攤薄	0.034	0.188	(81.9)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	4,545	4,103	10.8 %
產能利用率	99.5 %	94.3 %	5.2
淨資產收益率	0.9 %	6.3 %	(5.4)

二零二四年度

- 銷售收入 20.040 億美元, 較上年度下降 12.3%, 主要由於平均銷售價格下降, 部分被付運晶圓數量上升所抵消。
- 毛利率 10.2%, 較上年度下降 11.1 個百分點, 主要由於平均銷售價格下降及折舊成本上升。
- 經營開支 3.609 億美元, 較上年度上升 8.4%, 主要由於研發開支上升, 及新工廠的運營費用上升。
- 其他收入淨額 2,200 萬美元, 較上年度上升 12.5%, 主要由於利息收入上升, 部分被政府補貼下降所抵消。
- 年內損失 1.404 億美元, 上年度為年內溢利 1.264 億美元。
- 母公司擁有人應占溢利 5,810 萬美元, 上年度為 2.800 億美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元, 上年度為 0.189 美元。
- 淨資產收益率 0.9%, 上年度為 6.3%。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二四年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	512,677	95.1 %	436,375	95.8 %	76,302	17.5 %
其他	26,500	4.9 %	18,986	4.2 %	7,514	39.6 %
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度 95.1%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二四年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	252,234	46.8 %	250,743	55.1 %	1,491	0.6 %
12 吋晶圓	286,943	53.2 %	204,618	44.9 %	82,325	40.2 %
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.522 億美元及 2.869 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二四年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	450,782	83.7 %	366,508	80.5 %	84,274	23.0 %
北美 ⁴	48,120	8.9 %	36,811	8.1 %	11,309	30.7 %
亞洲 ⁵	23,878	4.4 %	30,176	6.6 %	(6,298)	(20.9)%
歐洲	14,258	2.6 %	18,475	4.1 %	(4,217)	(22.8)%
日本 ⁶	2,139	0.4 %	3,391	0.7 %	(1,252)	(36.9)%
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.508 億美元，占銷售收入總額的 83.7%，同比增長 23.0%，主要得益於閃存、MCU、超級結、邏輯及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,810 萬美元，同比增長 30.7%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,390 萬美元，同比下降 20.9%，主要由於超級結、邏輯、及通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,430 萬美元，同比下降 22.8%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於日本的銷售收入 210 萬美元，同比下降 36.9%，主要由於超級結產品的需求下降。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第四季度	第四季度	第四季度	第四季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
嵌入式非易失性存儲器	137,184	25.4 %	112,026	24.6 %	25,158	22.5 %
獨立式非易失性存儲器	46,056	8.5 %	14,753	3.2 %	31,303	212.2 %
分立器件	164,954	30.7 %	182,377	40.2 %	(17,423)	(9.6)%
邏輯及射頻	67,491	12.5 %	56,227	12.3 %	11,264	20.0 %
模擬與電源管理	122,618	22.7 %	89,448	19.6 %	33,170	37.1 %
其他	874	0.2 %	530	0.1 %	344	64.9 %
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.372 億美元，同比增長 22.5%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 4,610 萬美元，同比增長 212.2%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.650 億美元，同比下降 9.6%，主要由於 IGBT 產品的需求下降，部分被通用 MOSFET 及超級結產品需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 6,750 萬美元，同比增長 20.0%，主要得益於邏輯及 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.226 億美元，同比增長 37.1%，主要得益於其他電源管理及模擬產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	仟美元	%
55nm 及 65nm	129,033	23.9 %	60,920	13.4 %	68,113	111.8 %
90nm 及 95nm	106,414	19.7 %	82,552	18.1 %	23,862	28.9 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	70,233	13.0 %	73,762	16.2 %	(3,529)	(4.8)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	31,328	5.8 %	31,049	6.8 %	279	0.9 %
0.25 μ m	2,724	0.5 %	5,357	1.2 %	(2,633)	(49.2)%
0.35 μ m 及以上	199,445	37.1 %	201,721	44.3 %	(2,276)	(1.1)%
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 1.290 億美元，同比增長 111.8%，主要得益於閃存及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.064 億美元，同比增長 28.9%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 7,020 萬美元，同比下降 4.8%，主要由於智能卡芯片及邏輯產品的需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,130 萬美元，同比增長 0.9%。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 270 萬美元，同比下降 49.2%，主要由於 RF 及邏輯產品的需求下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.994 億美元，同比下降 1.1%，主要由於 IGBT 產品的需求下降，部分被智能卡芯片、通用 MOSFET、超級結、其他電源管理及模擬產品的需求增加所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二四年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第四季度 % (未經審核)	二零二三年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	344,594	63.9 %	252,508	55.4 %	92,086	36.5 %
工業及汽車	124,037	23.0 %	138,628	30.4 %	(14,591)	(10.5)%
通訊	64,619	12.0 %	53,973	11.9 %	10,646	19.7 %
計算機	5,927	1.1 %	10,252	2.3 %	(4,325)	(42.2)%
銷售收入總額	539,177	100.0 %	455,361	100.0 %	83,816	18.4 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.446 億美元，占銷售收入總額的 63.9%，同比增長 36.5%，主要得益於閃存、其他電源管理、超級結、MCU、通用 MOSFET、及邏輯產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.240 億美元，同比下降 10.5%，主要由於 IGBT 產品需求下降，部分被 MCU 及其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,460 萬美元，同比增長 19.7%，主要得益於模擬、CIS、其他電源管理及智能卡芯片產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 590 萬美元，同比下降 42.2%，主要由於通用 MOSFET、超級結及 MCU 產品的需求下降。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合仟片晶圓)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	95	95	95
合計產能(折合 8 吋仟片晶圓)	391	391	391
產能利用率 (200mm)	105.8%	91.0%	113.0%
產能利用率 (300mm)	100.9%	77.5%	98.5%
總體產能利用率	103.2%	84.1%	105.3%

- 本季度末月產能 391,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 103.2%，較上季度下降 2.1 個百分點。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋片晶圓	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,213	951	1,200	27.5 %	1.1 %

- 本季度付運晶圓 1,213,000 片，同比上升 27.5%，環比上升 1.1%。

經營開支分析

以仟美元計	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,617	2,684	2,241	(2.5)%	16.8 %
管理費用 ⁹	108,009	92,379	79,189	16.9 %	36.4 %
經營開支	110,626	95,063	81,430	16.4 %	35.9 %

- 經營開支 1.106 億美元，同比和環比分別上升 16.4%和 35.9%，主要由於研發工程片開支上升，及新工廠的運營費用上升。

其他(損失)/收入淨額

以仟美元計	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,481	3,447	3,612	1.0 %	(3.6)%
利息收入	20,450	20,182	26,710	1.3 %	(23.4)%
匯兌(損失)/收益	(48,664)	27,041	29,270	(280.0)%	(266.3)%
分佔聯營公司(損失)/溢利	(433)	7,136	1,087	(106.1)%	(139.8)%
財務費用	(20,406)	(19,540)	(27,275)	4.4 %	(25.2)%
政府補貼	4,705	51,387	18,535	(90.8)%	(74.6)%
其他	399	(2,053)	(142)	(119.4)%	(381.0)%
其他(損失)/收入淨額	(40,468)	87,600	51,797	(146.2)%	(178.1)%

- 其他損失淨額 4,050 萬美元，上年同期及上季度分別為其他收入淨額 8,760 萬美元及 5,180 萬美元，主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期及上季度為外幣匯兌收益，以及本季度政府補貼減少。

⁹管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二三年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得/(用)現金流量淨額	308,108	196,546	(26,838)	56.8 %	(1,248.0)%
投資活動所用現金流量淨額	(1,444,013)	(301,916)	(715,920)	378.3 %	101.7 %
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(50,929)	642,297	(5,007)	(107.9)%	917.2 %
外匯匯率變動影響淨額	(120,783)	58,753	90,648	(305.6)%	(233.2)%
現金及現金等價物變動影響淨額	(1,307,617)	595,680	(657,117)	(319.5)%	99.0 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 3.081 億美元，同比上升 56.8%，主要由於本季度客戶收款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 14.440 億美元，其中包括固定資產投資支出 15.057 億美元，部分被收到政府對設備的補助 4,120 萬美元，利息收入 1,790 萬美元，及處置其他權益工具投資 260 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 5,090 萬美元，其中償還銀行借款 9,150 萬美元，支付利息 5,050 萬美元，及支付租賃負債 40 萬美元，部分被提取銀行借款 8,450 萬美元，收到政府對財務費用的補助 550 萬美元，及員工行權發行股份收到 150 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)
資產總額	12,415,108	13,082,459
負債總額	3,508,489	3,867,040
所有者權益總額	8,906,619	9,215,419
資產負債率 ⁹	28.3%	29.6%

資本開支

以仟美元計	二零二四年 第四季度 (未經審核)	二零二四年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	21,159	28,607
華虹無錫	43,833	87,754
華虹製造	1,440,717	617,708
合計	1,505,709	734,069

- 本季度資本開支 15.057 億美元，其中 14.407 億美元用於華虹製造，4,380 萬美元用於華虹無錫，及 2,110 萬美元用於華虹 8 吋。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)
發展中物業	221,905	225,711
存貨	467,060	487,480
貿易應收款項及應收票據	270,461	268,186
預付款項、其他應收款項及其他資產	363,997	269,191
應收關聯方款項	18,324	25,426
已凍結存款及定期存款	31,624	32,443
現金及現金等價物	4,459,132	5,766,749
流動資產總額	5,832,503	7,075,186
貿易應付款項	298,372	273,352
其他應付款項及暫估費用	880,447	1,237,992
計息銀行借款	280,704	262,296
租賃負債	4,912	4,451
政府補助	57,563	40,072
應付關聯方款項	9,125	10,167
應付所得稅	31,115	26,494
流動負債總額	1,562,238	1,854,824
淨營運資金	4,270,265	5,220,362
速動比率	3.3x	3.4x
流動比率	3.7x	3.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	45	47
存貨周轉天數	90	92

- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 2.692 億美元上升至本季度末的 3.640 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 2,540 萬美元下降至本季度末的 1,830 萬美元，主要由於本季度收到一家關聯方的租賃款。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 12.380 億美元下降至本季度末的 8.804 億美元，主要由於本季度支付應付資本開支。
- 應付所得稅由上季度末的 2,650 萬美元上升至本季度末的 3,110 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支。
- 淨營運資金 本季度末 42.703 億美元，流動比率 3.7。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 45 天。
- 存貨周轉天數 90 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
 簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)
銷售收入	539,177	455,361	526,306
銷售成本	(477,751)	(437,141)	(462,299)
毛利	61,426	18,220	64,007
其他收入及收益	29,155	100,442	78,092
投資物業的公平值(損失)/收益	(39)	103	-
銷售及分銷費用	(2,617)	(2,684)	(2,241)
管理費用	(108,009)	(92,379)	(79,189)
其他費用	(48,745)	(541)	(107)
財務費用	(20,406)	(19,540)	(27,275)
分佔聯營公司(損失)/溢利	(433)	7,136	1,087
稅前(損失)/溢利	(89,668)	10,757	34,374
所得稅開支	(6,596)	(7,210)	(11,461)
期內(損失)/溢利	(96,264)	3,547	22,913
以下各方應佔：			
母公司擁有人	(25,199)	35,386	44,816
非控股權益	(71,065)	(31,839)	(21,903)
持有人應佔每股盈利			
基本	(0.015)	0.021	0.026
攤薄	(0.015)	0.021	0.026
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,718,222,223	1,716,439,808	1,717,612,830
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,724,086,667	1,720,215,394	1,721,402,553

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股数除外)

	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (已審核)
銷售收入	2,003,993	2,286,113
銷售成本	(1,798,865)	(1,799,017)
毛利	205,128	487,096
其他收入及收益	149,072	144,370
投資物業的公平值(損失)/收益	(39)	103
銷售及分銷費用	(9,628)	(10,189)
管理費用	(351,276)	(322,868)
其他費用	(33,395)	(33,666)
財務費用	(97,113)	(100,497)
分佔聯營公司溢利	3,459	9,230
稅前(損失)/溢利	(133,792)	173,579
所得稅開支	(6,593)	(47,154)
期內(損失)/溢利	(140,385)	126,425
以下各方應佔：		
母公司擁有人	58,108	280,034
非控股權益	(198,493)	(153,609)
持有人應佔每股盈利		
基本	0.034	0.189
攤薄	0.034	0.188
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,717,346,778	1,477,978,482
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,721,085,846	1,486,531,954

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二三年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	5,859,117	5,198,989	3,519,292
投資物業	164,153	168,433	166,643
使用權資產	77,761	81,372	78,545
無形資產	31,456	38,897	49,827
於聯營公司的投資	139,799	144,534	139,099
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	289,311	290,857	270,506
長期預付款項	21,008	83,396	149,953
遞延稅項資產	-	795	-
非流動資產總額	6,582,605	6,007,273	4,373,865
流動資產			
發展中物業	221,905	225,711	178,828
存貨	467,060	487,480	449,749
貿易應收款項及應收票據	270,461	268,186	278,669
預付款項、其他應收款項及其他資產	363,997	269,191	33,821
應收關聯方款項	18,324	25,426	11,219
已凍結存款及定期存款	31,624	32,443	32,088
現金及現金等價物	4,459,132	5,766,749	5,585,181
流動資產總額	5,832,503	7,075,186	6,569,555
流動負債			
貿易應付款項	298,372	273,352	235,410
其他應付款項及暫估費用	880,447	1,237,992	430,478
計息銀行借款	280,704	262,296	193,035
租賃負債	4,912	4,451	3,076
政府補助	57,563	40,072	35,017
應付關聯方款項	9,125	10,167	13,876
應付所得稅	31,115	26,494	61,495
流動負債總額	1,562,238	1,854,824	972,387
流動資產淨額	4,270,265	5,220,362	5,597,168
總資產減流動負債	10,852,870	11,227,635	9,971,033
非流動負債			
計息銀行借款	1,917,235	1,983,494	1,906,526
租賃負債	18,068	19,334	19,129
遞延稅項負債	10,948	9,388	30,834
非流動負債總額	1,946,251	2,012,216	1,956,489
淨資產	8,906,619	9,215,419	8,014,544
權益和負債權益			
股本	4,938,457	4,936,472	4,933,559
儲備	1,308,569	1,478,303	1,367,436
本公司擁有人應佔權益	6,247,026	6,414,775	6,300,995
非控股權益	2,659,593	2,800,644	1,713,549
權益總額	8,906,619	9,215,419	8,014,544

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日	於十二月三十一日	於九月三十日
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前(虧損)/溢利	(89,668)	10,757	34,374
折舊及攤銷	142,306	129,135	143,557
應佔聯營公司損失/(溢利)	433	(7,136)	(1,087)
營運資金的變動及其它	255,037	63,790	(203,682)
經營活動所得/(用)現金流量淨額	308,108	196,546	(26,838)
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(1,505,709)	(331,369)	(734,069)
收到政府對設備的補助	41,149	11,692	-
其他投資活動所得現金流量	20,547	17,761	18,149
投資活動所用現金流量淨額	(1,444,013)	(301,916)	(715,920)
融資活動現金流量：			
非控股權益資本注資	-	491,723	-
提取銀行貸款	84,551	246,620	2,287
發行股份所得收益	1,478	1,407	1,471
償還銀行貸款	(91,518)	(54,942)	(4,476)
已付利息	(50,498)	(45,234)	(3,283)
向股東支付股息	-	-	(7,371)
已抵押存款減少	-	-	7,369
支付租賃負債	(401)	(274)	(1,004)
收到政府對財務費用的補助	5,459	2,997	-
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(50,929)	642,297	(5,007)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(1,186,834)	536,927	(747,765)
外匯匯率變動影響淨額	5,766,749	58,753	90,648
期初現金及現金等價物	(120,783)	4,989,501	6,423,866
期末現金及現金等價物	4,459,132	5,585,181	5,766,749

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (已審核)
經營活動現金流量：		
稅前(虧損)/溢利	(133,792)	173,579
折舊及攤銷	555,832	500,439
應佔聯營公司溢利	(3,459)	(9,230)
營運資金的變動及其它	239	(23,093)
經營活動所得現金流量淨額	418,820	641,695
投資活動現金流量：		
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(2,739,182)	(906,607)
購買其他權益工具	(17,618)	-
收到政府對設備的補助	41,149	11,692
其他投資活動所得現金流量	84,794	61,603
投資活動所用現金流量淨額	(2,630,857)	(833,312)
融資活動現金流量：		
發行股份所得收益	3,642	2,941,945
非控股權益資本注資	1,181,880	787,920
提取銀行貸款	289,285	615,415
償還銀行貸款	(183,524)	(422,120)
已付利息	(105,736)	(106,570)
向股東支付股息	(36,247)	-
已抵押存款增加	-	(31,214)
支付租賃負債	(4,634)	(4,597)
其他融資活動所用現金流量	5,459	967
融資活動所得現金流量淨額	1,150,125	3,781,746
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(1,061,912)	3,590,129
外匯匯率變動影響淨額	5,585,181	(13,713)
期初現金及現金等價物	(64,137)	2,008,765
期末現金及現金等價物	4,459,132	5,585,181

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

唐均君(董事長)
白鵬(總裁)

非執行董事

葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
封松林

承董事會命

華虹半導體有限公司
唐均君
董事長兼執行董事

中國 香港

二零二五年二月十三日